

武汉农尚环境股份有限公司

关于公司对外投资进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况

2020年9月27日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司签署投资意向书的议案》，董事会同意公司与韩国 Nexia Device Co.,LTD、苏州内夏半导体有限责任公司签署投资意向书，公司拟出资对苏州内夏半导体进行增资，认缴苏州内夏半导体注册资本 5,100 万元，持股 51% 股权，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日、10 月 29 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签署投资意向书的公告》（公告编号：2020-081）和《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-089）。

2021 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对苏州内夏投资的议案》和《关于全资子公司向股东借款暨关联交易的议案》，董事会同意公司全资子公司武汉芯连微出资 5,100 万元人民币货币资金，对韩国内夏全资子公司苏州内夏进行增资，并授权公司全资子公司武汉芯连微签订本次投资的相关合同和协议；同意武汉芯连微向公司主要股东嘉兴昆兆讯芯投资合伙企业（有限合伙）借款 5,100 万元人民币，用于对苏州内夏增资。具体内容详见公司 2021 年 1 月 23 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司对外投资进展的公告》（公告编号：2021-003），以及 2021 年 2 月 2 日披露的《关于公司对外投资进展的公告暨全资子公司签署对外投资相关协议的公告》（公告编号：2021-011）。

二、进展情况

近日，公司接到苏州内夏半导体有限责任公司完成了相关工商变更登记手续的通知，并取得了苏州市虎丘区市场监督管理局颁发的《营业执照》，其相关信息如下：

名称：苏州内夏半导体有限责任公司

统一社会信用代码：91320505MA20T5AB6M

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：龚树峰

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2020 年 01 月 10 日

营业期限：2020 年 01 月 10 日至 2070 年 01 月 09 日

住所：苏州高新区金山东路 78 号 1 幢 Z101 室三层 313

经营范围：研发、设计、委托生产：通讯设备、电器设备及其他机电设备的内置芯片；自产产品的技术咨询；销售自产产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件

《苏州内夏半导体有限责任公司营业执照》

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2021年4月1日